**附件1：报名回执**

**“第十四届中国电子铜箔技术·市场研讨会”会议回执**

|  |  |
| --- | --- |
| **参会单位** |  |
| 姓 名 | 职 务 | 手机 | E-mail |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **开票资料** | 公司名称 | 纳税人识别号 | 地址 | 电话 | 开户行及账号 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |

**注意事项：请参会代表务于10月26日前将会议回执和公司开票资料以邮件方式传回协会秘书处；请务于10月26日前与酒店联系订房，逾期将不保证房源。**